



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 18684

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2024 年第一季度自结财务报告

2024 年 4 月 26 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(26)日公告 2024 年第一季度自结财务报告。

2024 年第一季度财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 44.42 亿元，较前季减少 8.7%，较去年同期增加 55%
- ◆ 本季合并毛利率为 22.4%，较前季减少 7 个百分点；
本季营业净利率为 4.1%，较前季减少 9 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 1.84 亿元，较前季减少 71%
- ◆ 本季归属于母公司净利为新台币 4.07 亿元，前季为新台币 3.85 亿元；
本季每股盈余为新台币 0.96 元，前季为新台币 0.91 元

2024 年第二季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第二季营收预计较前一季成长 low-teens 百分比。
- ◆ 第二季毛利率预计约为 mid-twenties 的水平。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

“2024年第一季度如之前预料的进入传统淡季，合并营收为新台币44.42亿元，较前一季下滑8.7%，与去年同期相比则大幅成长55%，也略优于原先的预期。由于产能利用率自上一季的60%下滑到55%，以及产品组合的不利因素，加上受到合并子公司所持有的中国客户上市股票本季股价波动影响，本季营业毛利率自上一季的29.4%下滑到22.4%，营业净利率也因此自上一季的13.1%下滑到4.1%。第一季归属于母公司净利为新台币4.07亿元，EPS为新台币0.96元。

回顾第一季各项产品的营收变化中，Wi-Fi 在终端市场顺利去化库存之后营收成长最为显著，而且是继去年第二季之后首次恢复正成长。Cellular 则仍然延续去年下半年的动能不减，营收水平与前一季相当，以上二者本季都可以视为淡季不淡。至于Infra 营收金额一贯是上下幅度不大，本季则是略低于上一季的水平。最后，Optical 则是本季营收下滑最明显的产品，主要是因为3D感测终端产品出货旺季已过，加上今年终端客户增加新供货商所致。

智能型手机市场在过去遭遇了长达1年半的库存调整，同时也历经了高阶手机的销售不振，在手机差异性不大的情况之下，造成零组件供货商沦于杀价竞争的不健康现象。最近依据研究机构 Counterpoint Research 最新发表的预测，2024年全球智能型手机全年出货成长率预估将为3%，年出货量也将回升到12亿支的水平，同时它们认为年成长率最高的将会是高阶机种(Premium Segment)，年增率预估高达17%。而高阶手机的特性一向是强调创新、注重质量及效能(performance)，有别于中低阶手机总是优先考虑价格而牺牲性能。而稳懋在高阶智能型手机市场一直有很高的市占率，这是因为我们每年投入大量的研发经费，用以提供给客户最先进、高效能的代工技术与服务，协助客户打入高阶市场，以提供客户更高的附加价值为稳懋的策略及经营模式，因此我们乐见这样的趋势回归，也期待未来的营收及获利能因而受益。

展望2024第二季，预期在智能型手机及Wi-Fi的需求带动之下，营收将较前一季成长 low-teens 百分比，毛利率约为 mid-twenties 的水平。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。